「スーパーセンダスト」系薄膜の軟磁気特性に及ぼす

SiO2の添加効果

日大生産工(院)	王	鋒	
日大生産工	新妻	清純・移川	欣男

<u>1.はじめに</u>

2007年10月,日立製作所と日立グローバ ルストレージテクノロジーズは HDD の記録密 度を現行製品の5倍に当たる1Tビット/平方 インチ級に高める磁気ヘッドの基本技術を開 発したと発表した 1)。このことから 3.5 イン チディスク1枚でも1Tバイトを超える大容量 HDD の実現が可能と考えられている。それ以 来,磁性材料を応用したデジタル家電向け HDD などのストレージデバイスは安価で大容 量化、小型化などのニーズに応えるため,垂 直記録方式における高密度記録,高速応答性 を有する材料の開発競争は盛んになっている。 特に,書き込み用薄膜ヘッド用材料において は、高飽和磁束密度,低磁歪,低保磁力,高電 気抵抗率であり,高周波帯域での損失などが 少なく,高い実効透磁率を有することが求め られている。

6.0wt%Si-4.0wt%Al-3.2wt%Ni-bal.Fe の組 成を有する「スーパーセンダスト(I)[SS(I)] 系合金は飽和磁束密度 Bs=1.6T,保磁力 Hc=1.6A/m,最大透磁率 μ_m =42000,初透磁率 μ_i =4100,飽和磁歪 s=0 と優れた軟磁気 特性²⁾を有しているため,書き込みヘッドに 適した磁性材料であると言える。金属磁性粒 子と非磁性絶縁体からなるナノグラニュラー 構造の磁性薄膜は,粒径がナノスケールの金 属磁性粒子と,それを取り囲む非磁性絶縁体 の粒界からなる構造を有するため,高周波に おける軟磁気特性,トンネル型磁気抵抗効果 (TMR)などを有することが報告されている³⁾。

そこで,本研究では,RFマグネトロンスパ ッタリング法を用いて,アルゴンガス雰囲気 中で,SiO₂を添加することによりナノグラニ ュラー構造を有する SS(I)系薄膜の作製を試 み,SS(I)系薄膜の軟磁気特性に及ぼす結晶構 造等の影響について検討した。

<u>2.実験方法</u>

SiO₂を含有する SS(I)系薄膜の作製には RF マグネトロンスパッタ装置を用いた。装置の 概略を Fig.1 に示す。



Fig.1 Schematic diagram of *RF* magnetron sputtering apparatus .

真空チャンバー内にターゲットである陰極 とそれに対向するように基板ホルダの陽極が 設置され,高周波プラズマ放電とターゲット 下部に設置された磁石の磁場によって,高い プラズマ状態が形成され,基板上に効率良く 薄膜が堆積するようになっている⁴⁾⁵⁾。

Effect of *SiO*₂ Addition for Soft Magnetic Properties of Super Sendust System Thin Films Feng WANG,Kiyozumi NIIZUMA and Yoshio UTSUSHIKAWA SS(1)系合金薄膜試料を作製する際には 6.7wt%Si-4.5wt%Al-3.2wt%Ni-bal.Fe の組成 を有する合金ターゲットを用いた。薄膜に SiO₂を添加するため,SiO₂チップをターゲット 上で中心より25mmの円周上に等間隔に配置 させた⁶⁾。その後,チャンバー内を4.0×10⁻⁴Pa 以下まで高真空排気し,純Ar ガスを用いて チャンバー内の圧力を4.0Paとし,投入電力 が400Wの下で放電させた。SiO₂チップと ターゲットの面積比を0~8%と変化させ,膜 厚を1µmとなるように成膜した。

なお,基板には磁気特性ならびに結晶構造 解析にはソーダライムガラス基板を,組成, 状態分析には無酸素銅基板をそれぞれ用い, 基板加熱は行わなかった。作製した SS(1)系 薄膜試料の飽和磁化 Ms ならびに保磁力 Hc の 測定には振動試料型磁力計(VSM),結晶磁気異 方性の測定にはバランシングコイル型トルク 計,比実効透磁率µ,の測定にはフェライトヨ ーク法,組成分析ならびに状態分析には電子 線マイクロアナライザ(EPMA),結晶構造解析 にはCu-K を線源とするX線回折装置(XRD), 表面観察には原子間力顕微鏡(AFM),電気抵抗 率 の測定には Van der Pauw 法,膜厚の測定 には繰り返し反射干渉計,重量測定にはマイ クロ天秤をそれぞれ用いた。

<u>3.実験結果および考察</u>

<u>3.1 EPMA による SS(I)系薄膜の状態分析</u>

<u>3.1.1 Si-K</u> 線における状態分析



Fig.2 Si-K band spectra wavelength and peak intensities for SS(I) system thin films area ratio of SiO_2 chip for target.

種々の SiO₂ チップとターゲットの面積比で作 製された SS(I)系薄膜の Si-K 線における状態分 析を施し,そこから得られた Si-K バンドスペク トル強度およびピーク波長を Fig.3 に示す。

図より, Si-K バンドスペクトル強度 I は SiO₂ チップの面積比が 0%の時,最小値 8040cps を示し, SiO₂ チップの面積比の増加 に伴い,増加する傾向が認められ,SiO₂チップ の面積比が8%の時,最大値9460cpsを示した。

または,ピーク波長は 0.7123nm とほぼ一定 の値を示し,Si の標準ピーク波長 0.7126nm⁷⁾ よりわずかに小さいことが認められた。

<u>3.1.2 O-K</u> 線における状態分析

種々のSiO₂チップとターゲットの面積比で 作製されたSS(I)系薄膜のO-K 線における状 態分析を施し,そこから得られたO-K バンド スペクトル強度およびピーク波長をFig.3に示 す。



Fig.3 *O-K* band spectra wavelength and peak intensities for SS(I) system thin films on area ratio of SiO_2 chip for target.

図より, O-K バンドスペクトル強度 I は SiO₂チップの面積比が 0%のとき, 最小値 0 を 示し, SiO₂チップの面積比の増加と共に, 増 加する傾向が認められた。SiO₂チップの面積比 が 8%のとき, 最大値 340cps を示した。

または, ピーク波長は SiO₂ チップの面積比 が 0%のとき以外,2.365nm とほぼ一定の値を示 し,Oの標準ピーク波長2.362nm よりわずかに 大きいことが認められた。

3.2 VSM による磁気特性

種種々のSiO₂チップとターゲットの面積比

で作製された SS(I)系薄膜の VSM による磁気 特性を Fig.4 に示す。



Fig.4 Dependence of saturation magnetization *Ms* and coercive force *Hc* on area ratio of *SiO*₂ chip for target. 図より,飽和磁化 Ms は SiO₂チップの面積 比が 0%の時,最大値 2.31×10⁻⁴Wb・m/kgを 示し,SiO₂チップの面積比の増加につれ, わずかに減少する傾向が認められ,SiO₂チッ プの面積比が 7%の時,最小値 2.12×10⁻⁴ Wb・m/kg を示した。

保磁力 Hc は SiO₂チップの面積比が 0%の時, 最大値 2.04kA/m を示し,2%以上から SiO₂チッ プ面積比の増加に伴い,顕著に減少する傾向 が認められた。SiO₂の面積比が 8%の時の保磁 力 Hc は 0.51kA/m であり,最小値となった。

3.3 X線回折図形による結晶構造解析

種々のSiO₂チップとターゲットの面積比で 作製された SS(I)系薄膜の X 線回折図形を Fig.5 に示す。



図より,Si02の面積比が0~8%において は,2 =44.86°付近に(110),2 =65.55° 付近に(200),2 =82.86°付近に(211), 2 =99.62°付近に(220)からの回折線が認 められ,ターゲットと同じ体心立方晶であ ることが明らかとなった。また,格子定数 a は約0.2859nmであった。

<u>3.4 比実効透磁率µ, ならびに垂直磁気異方</u> 性値 K の SiO₂チップの面積比依存性

種々の SiO₂ チップとターゲットの面積 比で作製された SS(I)系薄膜について,容 易軸で周波数 f=10MHz における比実効透 磁率μ,ならびに垂直磁気異方性値 K の SiO₂の面積比依存性を Fig.6 に示す。



図より,比実効透磁率μ,はSiO₂チップ の面積比が0%の時,最小値54を示し,8% の時,最大値308を示した。また,比実 効透磁率μ,は3%以上から顕著に増加し ていることが明らかとなった。

垂直磁気異方性値 K は,SiO₂ チップ の面積比が 0%の時,最大値 18.38 × 10⁴J/m³を示し,SiO₂の面積比が 6%の時, 最小値 3.18×10⁴J/m³を示した。また,SiO₂ チップ面積比の増加と共に,垂直磁気異 方性値 K は減少する傾向を示したが,6 ~8%においてはほぼ一定と示し,保磁力と の相関が認められた。 <u>3.5 電気抵抗率 の SiO₂ チップの面積比依</u> 存性

種々のSi0,チップとターゲットの面積比で

作製された SS(1)系薄膜の電気抵抗率 の SiO₂チップの面積比依存性を Fig.7 に示す。 1.501.001.0002468SiO₂ area ratio [%] Fig.7 Dependence of electrical resistivity for SS(1) system thin films on area ratio of

図より,電気抵抗率 はSiO₂チップの面積 比が 0%の時,最小値 =0.94 μ ・m を示し, SiO₂チップの面積比が 6%の時,最大値 =1.07 μ ・m を示し,SiO₂チップの面積比の増加 につれ、増加する傾向が認められた。

 SiO_2 chip for target.

以上の実験結果を総括すると,面積比 8%ま で SiO₂ チップを添加することによって,飽和 磁化 Ms は約 8%若干低下したが,保磁力 Hc は 約 75%低減できた。それに対して垂直磁気異 方性値 K は Hc とほぼ比例して約 80%低減し, さらに比実効透磁率 µ,は約 80%向上し,K ならびに Hc とほぼ反比例することが認められ た。また,電気抵抗率 は約 10%増大した。 **4.まとめ**

RF マグネトロンスパッタリング法によ リ,Ar ガス雰囲気中でSiO₂チップとター ゲットの面積比を0~8%と変化させ,作 製したSS(I)系薄膜の軟磁気特性に及ぼ す結晶構造等の影響について検討した。本 実験の結果をまとめると次の通りである。 1)状態分析においては,SiO₂チップの面 積比の増加に伴って,Si-K およびO-K バ ンドスペクトル強度Iは共に増加する傾向を示 した。また,それぞれのピーク波長は標準ピー ク波長よりわずかに変位したことから SiO₂ と しての添加が確認できた。

2) X 線回折結果から SS(I)系薄膜の結晶構 造は体心立方晶であることが確認できた。 格子定数 a は約 0.2859nm であった。

3) SiO₂の面積比の増加に伴い,電気抵抗 率 は増加し,面積比 8%の時,最大値 1.07 µ ・mを示した。

4) SiO₂の面積比が 8%の時, 飽和磁化 Ms は 2.13×10⁻⁴Wb・m/kg, 保磁力 Hc は最小 値 0.51kA/m, 垂直磁気異方性値 K は 3.42×10⁴J/m³, 比実効透磁率µ, は, 最大 値µ,=308を示し, 最良の軟磁気特性とな った。以上のことから,「スーパーセンダ スト」系薄膜の軟磁気特性に及ぼす約 8% の SiO₂の添加効果が確認された。

参考文献

- 井原敏宏:「日立、超高密度を実現する HDD 磁気 ヘッドの新方式を開発・従来比 2.5~5 倍の 500G ~1T ビット/平方インチを実現可能に」(日経パ ソコンニュース 2007 年 10 月 15 日)
- 山本達治,移川欣男;日本金属学会誌, VOI.40, NO.10, 975(1975)
- 3) 田中陽一郎,彦坂和志,市原勝太郎;日本応用磁 気学会会誌,VOI.22, NO.10,(1998)
- 金原粲:「スパッタリング現象」東京大学出版 (1984)
- 5) 近藤 剛,新妻清純,移川欣男:「ナノ結晶を有 する Fe-Si-Al-Ni 系薄膜の軟磁気特性」電気学 会誌,120(2000),174-179
- 6) 有村唯史,新妻清純,移川欣男:「RF 方式による Fe-Si-AI-Ni 系薄膜の微細化と軟磁気特性に関 する研究」(平成 13 年度修士論文)
- 7) 副島啓義:「電子線マイクロアナリシス」日刊工業新聞社(1987)